



射出・押出成形用低ハロゲン難燃性コンパウンド

	密度	MFR (21.18N)	MFR (211.8N)	引張強さ	切断時 伸び	デュロメータ 硬さ	脆化温度 (F0)	酸素指数	発煙濃度	発生ガス 酸性度	難燃性	成形 収縮率 MD/TD	カラー	用途	特長
単位	g/cm ³	g/10min	g/10min	MPa	%	HDD	°C	-	-	pH	-	%	-		
銘柄															
NUC-9780	1.28	1.0	44	17	830	56	< -60	27	160	3.0	2mm V-0	1.0-2.0/ 0.5-1.5	自然色	難燃電線防護管 等、各種押出成形 用途	高難燃性を有し、カラーマスターバッチにより着色可能。 塩素化ポリエチレンと比較して、燃焼時の酸性ガスの発生が少ない。 耐摩耗性、低摩擦。 耐候性が付与されている。
	密度	MFR (21.18N)	MFR (211.8N)	引張強さ	切断時 伸び	デュロメータ 硬さ	脆化温度 (F50)	酸素指数	絶縁破壊 強度	体積固有 抵抗	難燃性	成形 収縮率 MD/TD	カラー	用途	特長
単位	g/cm ³	g/10min	g/10min	MPa	%	HDD	°C	-	kV/mm	ohm.cm	-	%	-		
銘柄															
NUCG-2661A	1.26	7.3	280	13	750	48	< -70	29	26	> 10 ¹³	2.5mm V-0	2.1-2.6/ 0.8-1.2*	黒色	線カバー等、各種 射出・押出成形用 途	高難燃性。 耐熱変形性が非常に優れている。 加工性が良い。 耐摩耗性が良好。 耐候性が付与されている。

* 金型:タイプD2, 樹脂温度:210°C, 金型温度:40°C, 射出速度:100mm/sec, 保圧:15sec, 冷却:20sec

注) 本カタログの数値は代表的な値を示したものでありますから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。



熱可塑性半導電性コンパウンド

	密度	MFR (211.8N)	引張強さ	切断時 伸び	体積固有 抵抗 23℃	カーボン	ベース 樹脂				用途	特長
単位	g/cm3	g/10min	MPa	%	ohm.cm	-	-					
銘柄												
NUC-9511	1.16	12	> 9	> 100	< 30	アセチレン BK	EEA				導電性を必要とするケーブル、各種成形品、半導電性架橋コンパウンド押出のスタートアップ・シャットダウン樹脂	押出のほか、各種成形が可能。ポリエチレン層との密着性が良好である。カーボンブラックの分散状態が良好なため、押出した半導電層の表面が非常に平滑である。

注) 本カタログの数値は代表的な値を示したものでありますから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。

接着性半導電性コンパウンド

	密度	MFR (21.18N)	融点 (DSC法)	引張破壊 応力	引張破壊 伸び	デュロメータ 硬さ	ピカット 軟化温度	剥離強度	体積固有 抵抗 23℃	ベース 樹脂	用途	特長
単位	g/cm3	g/10min	℃	MPa	%	HDD	℃	N/cm	ohm.cm	-		
銘柄												
GA-004BK	1.00	40	126	17	710	57	88	19	45	LLDPE	導電性と接着性を必要とする各種成形品、電力ケーブルの遮水テープ等の絶縁保護用途	良好な導電性を有している。金属や他のプラスチックとの接着が可能。良好なフィルム成形性がある。

注) 本カタログの数値は代表的な値を示したものでありますから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。